

中信建投证券股份有限公司

关于

**强一半导体（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市**

之

上市保荐书

保荐人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二五年十一月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郭家兴、张宇辰根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义.....	3
一、发行人基本情况.....	5
二、发行人本次发行情况.....	13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式.....	14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....	18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项.....	19
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明.....	20
七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程.....	21
八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的上市条件的说明.....	22
九、持续督导期间的工作安排.....	26
十、保荐人关于本项目的推荐结论.....	27

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、普通术语

中信建投证券、保荐人、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、本公司、强一股份	指	强一半导体（苏州）股份有限公司
强一有限	指	强一半导体（苏州）有限公司，发行人前身
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上市保荐书、本上市保荐书	指	《中信建投证券股份有限公司关于强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》
哈勃科技	指	深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
北京集成	指	北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙），发行人股东
置信信远	指	北京置信信远股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
浙港春霖	指	嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
南通圆周率	指	圆周率半导体（南通）有限公司，控股股东、实际控制人控制的其他企业
B 公司	指	在本上市保荐书中指代与公司有交易的同受 A 公司控制的相关交易主体。B 公司系全球领先的芯片设计厂商，包括 B1 公司、B2 公司以及 B3 公司等
WSTS	指	WSTS Inc. 是一家总部位于美国的非营利性共同利益公司，致力于提供可靠的半导体行业数据和预测

二、专业术语

探针卡	指	一种应用于半导体晶圆测试的硬件，是测试机与待测晶圆的接触媒介
晶圆	指	制造芯片等产品的衬底（也叫基片）。由于是圆形晶体材料，所以称为晶圆。按照直径进行分类，主要包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格
封装测试	指	封装系为芯片安装外壳，起到安放、固定、密封、保护芯片等作用；测试系检测封装前后的芯片性能、功能等是否可正常运作、是否符合设计规格

MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System，以微电子、微机械及材料科学为基础，研究、设计、制造具有特定功能的微型器件，MEMS 工艺可以将器件加工至极高的精度
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，常见的半导体材料有硅、硒、锗等
集成电路	指	是一种微型电子部件。采用半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块半导体（硅、锗等）或介质基片上，然后焊接封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的电子器件
稼动率	指	设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重
PCB	指	Printed Circuit Board，印制电路板

在本上市保荐书中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入所致。

本上市保荐书所引用的部分数据来自 Yole 等定期发布的相关探针卡行业报告，发行人购买该等报告支付正常订阅费用，但并非为本次发行上市专门定制。除此之外的其他有关行业统计数据及资料均来自不同的公开刊物、研究报告、网站等公开信息，公司未为该等第三方数据及资料支付费用或提供帮助。另外，本上市保荐书中的中国集成电路、中国半导体探针卡行业市场规模等系包括中国大陆、香港、澳门地区的情况。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称	强一半导体（苏州）股份有限公司
注册地址	苏州工业园区东长路 88 号 S3 栋
成立时间	2015 年 8 月 28 日
注册资本	9,716.9418 万元人民币
法定代表人	周明
董事会秘书	张子涵
联系电话	0512-80784831-8024
互联网网址	http://www.maxonesemi.com
主营业务	公司是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售
本次证券发行的类型	首次公开发行股票并在科创板上市

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人主营业务

公司是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力，是市场地位领先的拥有自主 MEMS 探针制造技术并能够批量生产、销售 MEMS 探针卡的厂商，打破了境外厂商在 MEMS 探针卡领域的垄断。根据公开信息搜集并经整理以及 Yole 的数据，2023 年、2024 年公司分别位居全球半导体探针卡行业第九位、第六位，是近年来唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的境内企业。

探针卡是一种应用于半导体生产过程晶圆测试阶段的“消耗型”硬件，是半导体产业基础支撑元件。作为晶圆制造与芯片封装之间的重要节点，晶圆测试能够在半导体产品构建过程中实现芯片制造缺陷检测及功能测试，对芯片的设计具有重要的指导意义，能够直接影响芯片良率及制造成本，是芯片设计与制造不可或缺的一环，对半导体产业链具有重要意义。因此，在人工智能、数字化技术不断革新的趋势下，探针卡的性能保证了在通信、计算机、消费电子、汽车电子以及工业等领域发挥决定性作用的半导体产品的可靠性。

2、核心技术情况

随着芯片性能的不断发展，晶圆测试要求不断提升，探针卡相关技术亦随之发展，逐步由传统机械加工方式发展为综合了先进激光技术和光刻工艺以构建微米尺寸零部件的 MEMS 工艺。

公司以市场及客户需求为导向，以自主创新为依托，持续保持较高研发投入、加强技术创新，形成了自身的核心竞争力。截至 2025 年 9 月 30 日，公司掌握 24 项核心技术，取得了授权专利 182 项，其中境内发明专利 72 项、境外发明专利 6 项。公司系市场地位领先的拥有自主 MEMS 探针制造技术并能够批量生产、销售 MEMS 探针卡的厂商。

对于探针，公司拥有多条制造 MEMS 探针的全流程产线，配备了先进的光刻、激光、刻蚀、电化学沉积、薄膜沉积、研磨、检测等探针制造关键设备。2D MEMS 探针方面，公司 6 项核心技术有效保证了探针的优良性能，实现了良好的应用；薄膜探针方面，公司 3 项核心技术在测试间距、针长以及测试寿命方面提升了探针的性能，逐步满足客户测试需求；2.5D MEMS 探针方面，公司 5 项核心技术保证了探针的良好性能，并在硬度、抗塑性等方面实现提升。

对于探针卡，发行人基于自身技术积累形成的 2D MEMS 探针卡具有装针数量大、耐电流高、测试寿命长、测试间距小、测试性能稳定、易于维护等特点；2.5D MEMS 探针卡具有并测数高、装针数量大、植针面积大等特点；薄膜探针卡具有测试频率高、测试性能稳定、测试寿命长等特点；在垂直探针卡方面，公司技术特点主要体现在装针数量大、测试寿命长，测试间距小、测试性能稳定等方面；在悬臂探针卡方面，公司凭借自身技术实现了装针数量大、测试寿命长，测试间距小等特点。

3、研发水平

技术创新是公司发展的动力源泉，为保持公司技术创新的可持续性，公司建立了一套完善的技术创新机制，具体如下：

（1）以客户需求为导向

由于公司产品具有高度定制化特征，公司技术创新坚持以市场及客户需求为导向。公司针对不同应用领域进行技术布局，将客户需求贯穿于研发和技术创新全流程。在研

发项目立项阶段即进行深入的市场调研、广泛收集客户的需求，充分论证项目的可行性；在研发过程中，公司贴近客户，与客户保持及时、畅通的沟通，准确、快速、全面地把握客户需求。此外，通过和客户的实时沟通，公司加深对于行业变化的理解，提前感知行业变化的趋势，从而及时开展产品技术改进和创新。

因此，公司坚持以市场及客户需求为导向的创新原则，协助客户降低制造成本、提高产品良率，从而形成公司与客户的互惠互利。

(2) 以行业趋势为引领

公司探针卡核心服务的半导体设计与制造技术门槛高、技术复杂度高，为了持续保持技术及创新优势，公司时刻关注行业发展的最新动态，深刻把握技术发展趋势，以市场与客户需求为导向，积极就提升产品性能、丰富产品种类、开发新工艺、拓展新应用领域等方面进行基础性、前沿性的创新研发，结合项目执行过程中遇到的技术难点积极钻研、不断创新，提高技术创新能力，充分发挥技术创新对自身技术实力与自主产品性能提升的拉动作用。公司以行业趋势为引领进行前瞻布局使公司技术储备有效服务于市场拓展和产品线延伸，为公司满足不断变化的市场需求、实现持续长远发展奠定基础。

(3) 以研发创新为目标

公司一直重视研发与创新，报告期内，公司研发费用分别为 4,604.11 万元、9,297.13 万元、7,853.73 万元和 6,706.25 万元，占营业收入的比例分别为 18.12%、26.23%、12.25% 和 17.91%，保持了较高比例的研发投入。未来，公司将结合市场与客户需求、行业技术发展方向和自身发展战略继续加大研发投入，为公司的持续创新提供强力保障。

(4) 以优秀人才为驱动

为保证公司研发能力及创新活力，公司积极拓宽人才引进渠道、加大人才引进力度、优化人才结构，从而形成满足公司业务需要的人才梯队。同时，公司不断健全激励机制和晋升机制，激发员工的创新热情，调动其积极性和创造性，为进一步提升公司的技术实力和创新活力提供良好的人才支撑。

(三) 发行人报告期的主要财务数据和财务指标

报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：

项目	2025-06-30 /2025年1-6月	2024-12-31 /2024年度	2023-12-31 /2023年度	2022-12-31 /2022年度
资产总额（万元）	148,239.05	127,665.90	96,001.48	93,390.23
归属于母公司所有者权益（万元）	126,328.55	112,259.80	88,370.78	85,860.00
资产负债率（合并）	14.78%	12.07%	7.95%	8.06%
资产负债率（母公司）	17.52%	13.85%	11.97%	11.37%
营业收入（万元）	37,440.21	64,136.04	35,443.91	25,415.71
净利润（万元）	13,788.43	23,309.70	1,865.77	1,562.24
归属于母公司所有者的净利润（万元）	13,788.43	23,309.70	1,865.77	1,562.24
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	13,669.03	22,704.92	1,439.28	1,384.07
基本每股收益（元）	1.42	2.40	0.19	0.16
稀释每股收益（元）	1.42	2.40	0.19	0.16
加权平均净资产收益率	11.57%	23.30%	2.15%	3.59%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	12,585.28	27,967.16	4,839.70	-3,774.58
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	17.91%	12.25%	26.23%	18.12%

上述财务指标的计算方法如下：

$$1、\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$2、\text{基本每股收益} = P_0 \div S, S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（四）发行人存在的主要风险

1、客户集中度较高及对关联客户存在重大依赖的风险

报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为 62.28%、75.91%、81.31% 和 82.84%，集中度较高；同时，由于公司客户中部分封装测试厂商或晶圆代工厂商为 B 公司提供晶圆测试服务时存在向公司采购探针卡及相关产品的情况，若合并考虑前述情况，公司来自于 B 公司及已知为其芯片提供测试服务的收入分别为 12,781.77 万元、23,915.10 万元、52,487.55 万元和 31,011.81 万元，占营业收入的比例分别为 50.29%、67.47%、81.84% 和 82.83%，公司对 B 公司存在重大依赖。

B 公司是全球知名的芯片设计企业，拥有较为突出的行业地位，其芯片系列多且出货量较大；同时，由于其芯片设计能力较强，所采购中高端探针卡较多，其探针卡平均探针数量更多，使得产品技术附加值、单价及毛利率均相对较高。报告期内，公司经营业绩的增长主要依赖于 B 公司对于晶圆测试探针卡需求的快速增长。目前，公司是 B 公司探针卡主要供应商之一，占 B 公司探针卡采购份额已经相对较高，未来进一步大幅增长的空间相对较小，公司来自于 B 公司的收入很可能无法持续保持快速增长。

报告期内，B 公司向公司采购产品或服务的价格与采购其他供应商同类型产品或服务的价格基本持平；从公司探针卡销售价格对比情况来看，B 公司与其他客户整体探针单价处于同一水平，与可获取的同行业公司数据处于同一水平。因此，报告期内，B 公司与公司交易价格公允、合理，不存在对公司进行利益输送的情况。同时，公司与 B 公司建立业务联系及合作关系的时点较早，且 B 公司采购公司探针卡（含维修）、PCB 产品时均履行了竞争性谈判程序，因此公司业务获取方式不影响独立性。

随着半导体制造工艺的发展，B 公司的芯片产品更新迭代速度较快，且对于晶圆测试的要求越来越高，若公司主要产品无法持续满足 B 公司的需求，则可能导致其对公

司采购金额下降；同时，若未来 B 公司芯片设计、晶圆代工或封装测试中的任一重要环节受到限制，均可能导致其芯片出货量下降，进而直接导致公司经营业绩下降。此外，在进入量产后，封装测试厂商或晶圆代工厂商为 B 公司提供晶圆测试服务时，会充分参考 B 公司量产之前验证过的供应商，因此任何导致 B 公司向公司采购额下降的事项，都将会进一步影响相关封装测试厂商或晶圆代工厂商向公司的采购额。

目前，公司与境内诸多知名半导体厂商或其下属公司建立了稳定、良好的合作关系，尽管公司在积极进行其他大客户的拓展，但由于公司下游市场格局以及产品研发验证周期等因素，预计在未来一定时期内仍将存在对以 B 公司为首的主要客户销售收入占比较高的情形。如果未来公司与主要客户（特别是 B 公司）的合作关系或下游市场的行业格局发生变化，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

2、供应商集中度较高且对部分原材料、设备单一或少数供应商同类采购占比较高的风险

报告期内，公司向前五大供应商采购金额分别为 6,663.80 万元、5,221.34 万元、9,817.61 万元和 8,634.72 万元，占采购总额的比例分别为 49.14%、40.19%、60.67%和 64.27%，集中度较高，主要系采购探针卡所需的 PCB、MLO、贵金属试剂、探针及机械结构部件等；同时，公司设备供应商集中度亦相对较高。

由于部分原材料、设备的稀缺性，公司存在向单一或少数供应商采购金额占同类原材料、设备采购金额比重较高的情形。公司系综合考虑供应商产品质量、合作历史以及交期等，基于最大限度保证产品交付的稳定性、及时性，采取同种原材料、设备主要通过单一或少数供应商采购的经营策略。目前，公司多种重要原材料、设备供应商主要系境外厂商或其境内分支机构，境内可替代的厂商相对较少。因此，如果未来公司与相关原材料、设备供应商合作关系发生变化，或相关供应商自身经营状况、交付能力发生重大不利变化，再或由于国际形势等因素无法进行正常交易，公司无法及时采取有效的替代措施，均将对公司经营业绩产生重大不利影响。

3、毛利率及经营业绩下降的风险

报告期内，受探针卡国产替代进程加速、公司毛利率较高的 MEMS 探针卡收入占比提高等因素影响，公司毛利率分别为 40.78%、46.39%、61.66%和 68.99%，扣除非经

常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,384.07 万元、1,439.28 万元、22,704.92 万元和 13,669.03 万元，均呈现良好的增长趋势。

根据公开信息搜集并经整理，2023 年半导体产业处于下行周期，全球探针卡市场规模有所下降；随着全球半导体产业的景气度回升以及我国半导体产业的快速发展，2024 年全球及我国半导体探针卡市场规模均快速增长，对公司毛利率及经营业绩起到了一定积极作用。若公司无法继续扩大主要产品市场份额、有效提升产品销售价格、控制关键原材料采购价格、提高产品制造良率，或因探针卡行业市场竞争加剧、晶圆测试需求减少等因素影响，都可能导致公司毛利率及经营业绩出现下降。

具体来看，2024 年度、2025 年 1-6 月公司 MEMS 探针卡销售收入占全部探针卡销售收入的比例分别为 84.05%、90.76%，高于全球半导体探针卡行业中 MEMS 探针卡市场规模占比，未来公司 MEMS 探针卡销售收入占比继续提升的空间较为有限；同时，2024 年度、2025 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 61.66%、68.99%，高于同行业可比公司平均水平，而公司部分重要原材料（如 PCB、MLO 等）均需要外购，且现阶段供应商数量相对有限，公司转嫁原材料价格波动的空间较小；此外，全球及我国探针卡行业快速发展，行业新进入者较多，未来公司面临的市场竞争环境可能更加激烈。因此，公司面临毛利率及经营业绩下降的风险。

4、营业收入无法保持快速增长的风险

报告期内，公司营业收入分别为 25,415.71 万元、35,443.91 万元、64,136.04 万元和 37,440.21 万元，保持持续快速增长，其中 2022-2024 年度复合增长率为 58.85%。从产品角度来看，公司营业收入的增长主要来自于 2D MEMS 探针卡销售收入增长；从客户角度来看，公司营业收入的增长主要来自于 B 公司以及为其提供晶圆测试服务的厂商；从行业角度来看，主要应用于存储领域的 2.5D MEMS 探针卡是公司未来重要的收入增长点。

因此，若未来公司无法持续保持 2D MEMS 探针卡竞争优势，或与 B 公司合作关系发生变化，再或 2.5D MEMS 探针卡市场推广速度不及预期，都可能导致公司营业收入无法保持快速增长。

5、关联交易金额较大的风险

报告期内，公司关联销售占营业收入的比例分别为 38.88%、40.09%、36.00% 和 25.97%，相对较高，主要是由于公司于 2020 年、2021 年分别推出的 2D MEMS 探针卡、薄膜探针卡获得 B 公司的认可，随着 B 公司业务快速发展，其对公司采购金额快速增长。公司基于实质重于形式原则将 B 公司认定为关联方；同时，公司外部机构投资者提名的董事、监事在半导体企业兼职较多，其中部分企业为公司客户。

为保证供应链稳定性，公司逐步在境内寻找产品核心部件及材料供应商。其中，报告期内，公司向南通圆周率采购 PCB、MLO 等产品及 PCB 贴片服务，其采购金额占营业成本的比例分别为 18.32%、8.91%、5.04% 和 5.54%，南通圆周率系公司实际控制人周明控制的企业。

未来公司预计将持续发生上述关联交易，公司关联交易，特别是关联销售金额相对较大、占比相对较高，对公司经营业绩影响较大。

6、综合竞争力与境外龙头探针卡厂商存在差距的风险

目前，探针卡行业由境外厂商主导。根据公开信息搜集并经整理，探针卡行业前十大厂商多年来均为境外厂商，合计占据了全球 80% 以上的市场份额。境外龙头探针卡厂商成立时间久、进入市场早、经营规模大、研发投入高，并面向全球市场提供服务，具有市场竞争优势。公司在技术实力、产品稳定性以及全球服务能力等方面较境外龙头厂商仍存在不同程度的差距。如果公司不能有效提升自身综合竞争力、提升产品品质或在境外拓展业务的过程受到政策、法律法规、政治等方面的限制，则将对公司拓展客户、扩大经营规模等方面带来不利影响。

7、未能保持与半导体技术同步发展的风险

公司聚焦晶圆测试所需核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。随着半导体制造工艺越来越先进，器件越来越复杂和精细，晶圆测试的要求越来越具有挑战性。因此，公司必须不断进行产品研发创新才能满足日益复杂的晶圆测试新要求。如果公司无法通过技术创新保持与半导体技术的同步发展，或者公司无法精准判断行业技术发展的趋势、及时应对行业技术的重大变革，则将影响公司产品的竞争力，进而对公司的生产经营产生不利影响。

8、半导体产业周期性波动风险

公司所处的半导体行业具有周期性，其特点是产品供需波动较大，主要和产品成熟与技术突破的更迭、产能周期以及宏观经济走势有关。根据 WSTS 的数据，受终端需求疲软影响，全球半导体行业自 2022 年下半年进入周期性低迷，行业市场规模 2023 年同比下降 8.3%至 5,269 亿美元；随着以人工智能、算力为代表的市场需求充分释放，2024 年全球半导体行业实现快速回升，达到 6,305 亿美元，并预计于 2025 年、2026 年保持快速增长态势。

探针卡行业与半导体行业的变动直接相关，例如芯片设计厂商的新产品研制、量产产品的出货，晶圆制造厂商的产能及稼动率等。当行业处于下行周期时，终端需求疲软可能会对公司的收入、毛利率产生不利影响，此外持续的低迷可能引致一个或多个客户的偿付能力受损，进而影响公司回收应收账款的能力。因行业周期性低迷的时间、长度和严重程度难以预测，如果公司未能做好计划或及时采取应对措施，则将对生产经营产生不利影响。

9、募集资金投资项目固定资产折旧、无形资产摊销的风险

公司本次募集资金投资项目的实施需要较大规模的固定资产（主要包括机器设备、房屋建筑物）及无形资产（主要包括土地使用权、软件）投入，预计固定资产投资 103,694.59 万元、无形资产投资 2,703.33 万元，在募集资金投资项目投产后，前述资产在经营期内预计每年对应的折旧摊销金额共计 8,327.31 万元。若公司本次募集资金投资项目达产后未能实现预期收益，相关折旧摊销金额将对公司盈利能力产生不利影响。

二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 3,238.99 万股	占发行后总股本的比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 3,238.99 万股	占发行后总股本的比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本的比例	不适用
发行后总股本	不超过 12,955.93 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（按发行价格除以发行后每股收益计算）		

发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行将采用网下向询价对象配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或者中国证监会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户并已开通科创板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	南通探针卡研发及生产项目		
	苏州总部及研发中心建设项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元。其中：承销及保荐费【】万元；审计及验资费【】万元；律师费【】万元；其他【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售认购本次公开发行新股的，公司将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件		
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用		

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）本次证券发行上市的保荐代表人

中信建投证券指定郭家兴、张宇辰担任本次强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

郭家兴先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理

委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目；北京同有飞骥科技股份有限公司重大资产重组项目；歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券项目；山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票项目；北京旋极信息技术股份有限公司股权激励财务顾问项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张宇辰先生：保荐代表人，中国注册会计师，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目；成都高新发展股份有限公司非公开发行股票项目；歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券项目；无锡华东重型机械股份有限公司重大资产重组项目、陕西建设机械股份有限公司重大资产重组项目、甘肃盛达集团股份有限公司收购甘肃皇台酒业股份有限公司项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为李书春，其执业情况如下：

李书春先生：中国注册会计师，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目；北京同有飞骥科技股份有限公司重大资产重组项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重

组项目；甘肃皇台酒业股份有限公司恢复上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括杨志、赵鸿川、荣光玉、黄泽森、莫凡人、李恒、武安邦、关峰、孙中凯。

杨志先生：具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目；北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目；甘肃皇台酒业股份有限公司恢复上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

赵鸿川先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目；云南省城市建设投资集团有限公司要约收购云南城投置业股份有限公司项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

荣光玉先生：保荐代表人，中国注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

黄泽森先生：保荐代表人，具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

莫凡人先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券项目、招金矿业股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券项目、青岛

西海岸新区海洋控股集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券项目、山东招金集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券项目、招金矿业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券项目；天津融诚物产集团有限公司收购四川浩物机电股份有限公司项目；奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目；北京海金格医药科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李恒先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

武安邦先生：保荐代表人，中国注册会计师，具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目、福建福特科光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目；汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转债项目、奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转债项目；镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司新三板挂牌等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

关峰先生：保荐代表人，中国注册会计师，本科学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票并在深交所上市项目、苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目；中航电测仪器股份有限公司重大资产重组项目、北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组项目、无锡华东重型机械股份有限公司重大资产重组项目、北京同有飞骥科技股份有限公司重大资产重组项目；歌尔股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目、通鼎互联信息股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

孙中凯先生：保荐代表人，中国注册会计师，本科学历。现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目、苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目；苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目；奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系地址：	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层
邮编：	100026
联系电话：	010-65608358
传真：	010-65608358

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）截至本上市保荐书签署日，发行人保荐人、主承销商中信建投证券的全资子公司中信建投投资有限公司及中信建投资本管理有限公司通过北京集成、浙港春霖、置信信远间接持有发行人0.81%的股份。除上述情况外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。此外，保荐人将根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规的规定，安排相关子公司参与本次发行战略配售。

（二）截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方

不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份导致影响公正履行保荐职责的情况。

（三）截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，或在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(七) 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

(八) 自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

(九) 中国证监会、上交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

(一) 董事会的批准

2024年11月20日，发行人召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

(二) 股东大会的批准

2024年12月5日，发行人召开2024年第三次临时股东大会，持有发行人100%股份的股东或其代表出席了会议。会议审议通过了发行人董事会提交审议的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

经核查，本保荐人认为，发行人已就本次首次公开发行股票并在科创板上市履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

（一）发行人符合科创板行业领域的规定

发行人是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。此外，公司所属的行业还是国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的“鼓励类”产业。

综上所述，发行人所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》第五条（一）中所规定的“新一代信息技术领域——半导体和集成电路”行业领域的要求。

（二）发行人符合科创属性规定的规定

2022-2024 年度，公司研发投入分别为 4,604.11 万元、9,297.13 万元和 7,853.73 万元，合计研发投入金额 21,754.97 万元；公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 17.40%。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第一款的规定。

2024 年 12 月 31 日，发行人研发人员 129 人，占当年末员工总人数的比例为 19.00%，已超过 10%。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第二款的规定。

截至 2025 年 9 月 30 日，发行人拥有可应用于公司主营业务并能够产业化的境内发明专利 72 项，已超过 7 项。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第三款的规定。

2022-2024 年度，发行人营业收入分别为 25,415.71 万元、35,443.91 万元和 64,136.04 万元，发行人最近三年营业收入复合增长率为 58.85%，已超过 25%；最近一年营业收入金额为 64,136.04 万元，已超 3 亿元。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》

第一条第四款的规定。

发行人不属于金融科技、模式创新企业，不属于房地产和主要从事金融、投资类业务的企业。因此，发行人符合《科创属性评价指引（试行）》第三条的规定。

八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的上市条件的说明

（一）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

1、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

（1）公司自整体变更设立以来，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和证监会的相关要求，结合公司实际情况逐步建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》等一系列公司治理制度，明确了股东会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

此外，发行人董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，并制定了相应的工作细则，有效地保证了公司的规范运作和可持续发展，形成了科学和规范的治理制度。2025 年 9 月，根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

综上所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

（2）根据立信会计师出具的无保留意见的《审计报告》以及保荐人的审慎核查，发行人具有持续经营能力。

综上所述，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（3）根据立信会计师出具的无保留意见的《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告。

综上所述，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

（4）根据发行人及其控股股东、实际控制人的说明、发行人提供的资料并经保荐人的审慎核查，截至本上市保荐书签署日，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

综上所述，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（5）发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项的规定。

2、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

中信建投证券对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

（1）经核查发行人工商档案、纳税资料、发起人协议等资料，发行人前身强一有限成立于2015年8月28日。2022年8月15日，强一有限召开股东会，同意强一有限以截至2022年5月31日为基准日整体变更为股份有限公司。2022年8月16日，强一有限全体股东共同签署《强一半导体（苏州）有限公司发起人协议》，约定以强一有限截至2022年5月31日经审计的净资产53,712.63万元按6.170483:1的比例折股整体变更设立股份公司。2022年9月9日，公司完成工商变更登记。

经核查发行人《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列公司治理制度，发行人相关会议文件，组织机构安排等资料，并访谈发行

人高级管理人员，发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，本保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册办法》第十条的规定。

(2) 经核查发行人内部控制流程、内部控制制度、会计记录、记账凭证、立信会计师事务所出具的无保留意见的《审计报告》、立信会计师事务所出具《内部控制鉴证报告》《内部控制审计报告》等资料，并访谈发行人财务负责人，本保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

(3) 经核查发行人业务经营情况、工商档案、主要资产权属证明文件、控股股东、实际控制人调查表、立信会计师事务所出具的无保留意见的《审计报告》等资料，并访谈发行人高级管理人员，本保荐人认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

(4) 经核查发行人报告期内主营业务收入构成、重大销售合同、主要客户资料等资料，发行人最近两年内主营业务未发生重大变化；经核查发行人工商档案，聘请董事、高级管理人员的相关会议决议，核心技术人员的《劳动合同》，发行人最近两年内董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，发行人核心技术人员稳定且最近两年内没有发生重大不利变化；经核查发行人工商档案，控股股东、实际控制人访谈文件等资料，最近两年发行人的实际控制人始终为周明，未发生变更。控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。本保荐人认为：发行人主营业务、控制权、管理团队稳定，符合《注册办法》第十

二条第（二）项的规定。

（5）经核查发行人主要资产清单、主要资产权属证明文件、立信会计师出具的无保留意见的《审计报告》、发行人律师出具的法律意见书、补充法律意见书等资料，本保荐人认为：发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

（6）经核查发行人主营业务情况，相关主管机构出具的有关证明文件，并经公开信息查询，本保荐人认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册办法》第十三条的规定。

（二）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

经核查，若本次拟公开发行的 3,238.99 万股股份全部发行完毕，发行人股本总额将达到人民币 12,955.93 万元，发行后股本总额不低于人民币 3,000.00 万元。

（三）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

经核查，根据发行人 2024 年 12 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，发行人拟公开发行不超过 3,238.99 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。

（四）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准”规定

根据《上市规则》第 2.1.2 条，发行人选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或

者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

发行人 2024 年度营业收入为 64,136.04 万元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 22,704.92 万元；结合发行人最近一次增资对应的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于 10 亿元。发行人符合《上市规则》中“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 1 亿元”的上市标准。

（五）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

九、持续督导期间的工作安排

事项	工作计划
（一）持续督导事项	
1、督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度。	根据相关法律法规，协助公司制订、完善有关制度，并督导其执行。
2、督导公司有效执行并完善防止董事、监事以及高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度。	根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助公司制定有关制度并督导其实施。
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见。	督导公司的关联交易按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易，本保荐人将按照公平、独立的原则发表意见。公司因关联交易事项召开董事会、股东会，应事先通知本保荐人，本保荐人可派保荐代表人与会并提出意见和建议。
4、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。	关注并审阅公司的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导公司履行信息披露义务。
5、持续关注公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。	定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席公司董事会、股东会，对公司募集资金投资项目的实施、变更发表意见。
6、持续关注公司为他人提供担保等事项，并发表意见。	督导公司遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。
（二）持续督导期限	发行人首次公开发行股票并在科创板上市当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度；持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，本保荐人将继续

事项	工作计划
	续完成。

十、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：本次强一股份发行上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为强一股份本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于强一半导体(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 李书春

李书春

保荐代表人签名: 郭家兴

郭家兴

张宇辰

张宇辰

内核负责人签名: 张耀坤

张耀坤

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

法定代表人/董事长签名: 刘成

刘成

